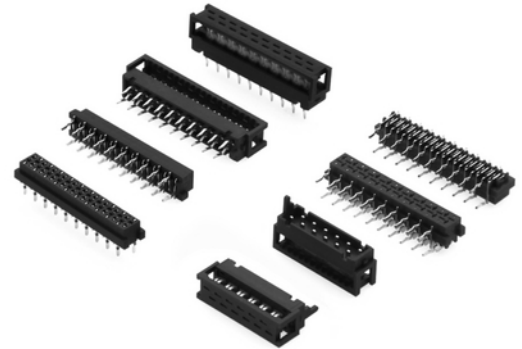


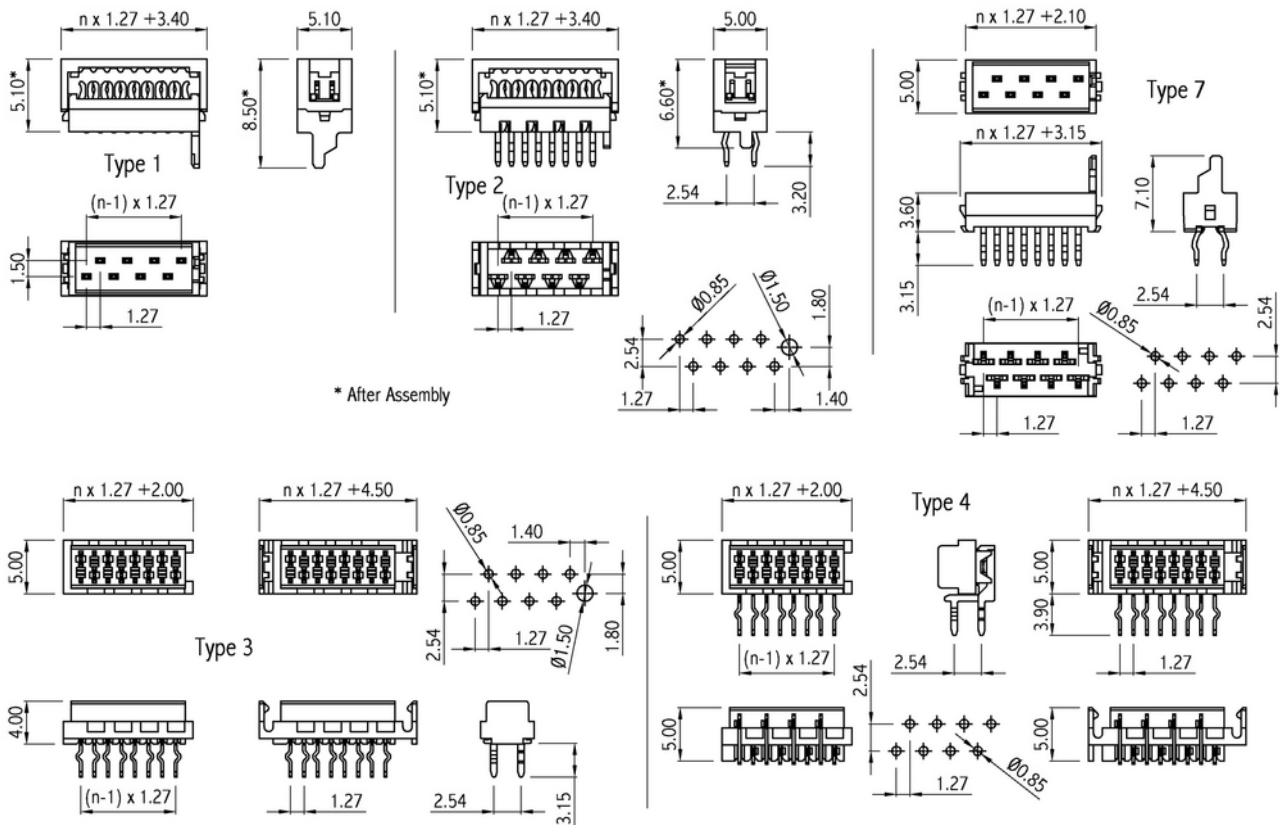
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0, rot
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0, red
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Lötbarkeit	IEC 60512-12A
Solderability	IEC 60512-12A
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
Insulation Resistance	> 1000MΩ
Spannungsfestigkeit	500V <sub>RMS</sub>
Test Voltage	500V <sub>RMS</sub>
Nennspannung	100V <sub>RMS</sub>
Voltage Rating	100V <sub>RMS</sub>
Nennstrom	1,5A
Current Rating	1.5A
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
Temperature Range	-40°C ... +105°C
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	Wave or reflow soldering



© W+P PRODUCTS

Kompatibel zur Serie 6990  
Compatible to series 6990



Series	Type*	Contacts*	Locking (Optional)*
<b>699</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>1</b>
	1 Stift zu Kabel Verbinder <i>Male-on-wire connector</i> 7 Stiftleiste gerade <i>Male-on-board, straight</i> 2 Leiterplattenverbinder <i>Paddle board connector</i> 3 Buchse, gerade <i>Female-on-board, straight</i> 4 Buchse, gewinkelt <i>Female-on-board, right-angled</i>	04/06/08/10/12/ 14/16/18/20	(0) Ohne Rast-Clip <i>W/o lock</i> 1 Mit Rast-Clip (für Buchse) <i>With lock (female connectors)</i>

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

TEL +49 5223 98507-0  
FAX +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL sales@wpro.com  
WEBSITE www.wpro.com

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

